

中国汽车芯片行业市场深度调研及发展趋势与投资前景研究报告(2024-2029版)

报告简介

传统汽车工业中，内燃机是汽车工业的价值和创新源泉，随着汽车电子技术日益成熟，汽车正在朝着电气化、自动驾驶、车联网以及移动性即服务的方向迈进。汽车芯片逐渐成为汽车的大脑，引领着汽车工业的产业升级。汽车芯片相比消费芯片及一般工业芯片，其工作环境更为恶劣，对可靠性及安全性的要求也更高，需要经过严苛认证流程，包括可靠性标准AEC-Q100、质量管理标准ISO/TS16949、功能安全标准ISO26262等。

半导体芯片在汽车领域的用途非常广泛，除了常见的多媒体娱乐系统、智能钥匙和自动泊车系统外，芯片还广泛应用在汽车发动机和变速箱控制系统、安全气囊、驾驶辅助系统、电动助力转向、ABS、电子稳定性系统(ESP)、行人保护、胎压控制、电动车窗、灯光控制、空调系统、座椅调节系统中，堪称汽车的神经。把国内厂商在车规级半导体领域的布局大致分为三大类：一是传统半导体厂商和车企，主要为传统生产车规级芯片的厂商和逐渐过渡为车规级半导体生产商的传统车企；二是初创或者新加入这个赛道的企业；三是通过并购整合切入汽车级半导体市场的企业。随着传统汽车的电气化、感知化、智能化、网络化，新型的智能网联汽车对于半导体数量的需求越来越大。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、工信部、51行业报告网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国汽车芯片市场进行了分析研究。报告在总结中国汽车芯片发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国汽车芯片的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为汽车芯片企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

报告目录

第一章 汽车芯片行业发展环境分析

第一节 国际环境

一、全球发展规模

二、亚太地区发展

三、欧洲主导市场

四、美国adas发展

第二节 政策环境

一、智能制造政策

二、集成电路政策

三、半导体产业规划

四、“互联网+”政策

第三节 经济环境

一、国民经济运行

二、工业经济增长

三、固定资产投资

四、城乡居民收入增长分析

五、居民消费价格变化分析

六、转型升级形势

七、宏观经济趋势

第四节 汽车工业

一、行业发展势头

二、市场产销规模

三、外贸市场规模

四、发展前景展望

第五节 社会环境

一、互联网加速发展

二、智能产品的普及

三、科技人才队伍壮大

第二章 2019-2023 年中国汽车芯片行业发展分析

第一节 2019-2023年中国汽车芯片发展总况

一、行业发展概述

二、产业发展形势

三、市场发展规模

第二节 2019-2023年中国汽车芯片市场竞争形势

一、市场竞争格局

二、巨头争相进入

三、半导体抢占主战场

第三节 2019-2023年汽车芯片技术发展进展

一、技术研发进展

二、无线芯片技术

三、技术发展趋势

第四节 中国汽车芯片行业发展困境分析

一、过度依赖进口

二、技术研发不足

三、行业发展瓶颈

第五节 中国汽车芯片市场对策建议分析

一、行业发展建议

二、产业突围策略

三、企业发展策略

第三章 2019-2023 年中国汽车芯片行业产业链分析

第一节 2019-2023年中国半导体材料行业运行状况

一、产业发展特点

二、行业销售规模

三、市场格局分析

四、产业转型升级

五、行业发展建议

六、行业发展趋势

第二节 2019-2023年中国芯片设计行业发展分析

一、产业发展历程

二、市场发展现状

三、市场竞争格局

四、企业专利情况

五、国内外差距分析

第三节 2019-2023年中国晶圆代工产业发展分析

一、晶圆加工技术

二、国外发展模式

三、国内发展模式

四、企业竞争现状

五、市场布局分析

六、产业面临挑战

第四节 2019-2023年中国芯片封装测试行业发展分析

一、封装技术介绍

二、芯片测试原理

三、主要测试分类

四、封装市场现状

五、封测竞争格局

六、发展面临的问题

七、技术发展趋势

第四章 2019-2023 年中国汽车芯片行业区域发展分析

第一节 长春

一、产业发展成就

二、企业投资动态

三、产业集群发展

第二节 芜湖

一、产业支撑政策

二、产业基地概况

三、企业项目建设

四、产业发展目标

五、产业发展规划

第三节 上海

一、行业发展成就分析

二、行业发展促进战略

三、产业发展专项方案

四、行业发展瓶颈分析

第四节 深圳

一、产业发展优势

二、产业发展成就

三、产业链的市场

四、产业发展动态

第五节 其他地区

一、合肥市

二、十堰市

三、东莞市

第五章 2019-2023 年汽车芯片主要应用市场发展分析

第一节 adas

- 一、 adas发展地位
- 二、市场竞争现状
- 三、技术创新核心
- 四、芯片技术发展
- 五、投资机遇分析
- 六、发展趋势分析
- 七、未来发展前景

第二节 abs

- 一、系统工作原理
- 二、系统优劣分析
- 三、中国发展进展
- 四、系统发展趋势

第三节 车载导航

- 一、市场发展现状
- 二、企业竞争格局
- 三、产品的智能化
- 四、发展问题剖析
- 五、未来发展方向

第四节 空调系统

- 一、市场发展形势
- 二、市场规模分析
- 三、企业竞争格局
- 四、未来发展方向

第五节 自动泊车系统

- 一、系统运作原理
- 二、关键技术发展
- 三、技术推进动态
- 四、未来市场前景

第六章 2019-2023 年汽车电子市场发展分析

第一节 国际汽车电子市场概况

- 一、主要产品综述
- 二、行业发展状况
- 三、市场规模发展

第二节 中国汽车电子行业发展概述

- 一、市场发展特点
- 二、产业发展地位
- 三、产业发展阶段
- 四、发展驱动因素
- 五、市场结构分析
- 六、引领汽车发展方向

第三节 2019-2023年中国汽车电子市场发展分析

- 一、市场规模现状
- 二、出口市场状况
- 三、市场结构分析
- 四、汽车电子渗透率

第四节 2019-2023年汽车电子市场竞争分析

- 一、整体竞争态势

二、市场竞争现状

三、区域竞争格局

四、市场竞争格局

五、本土企业竞争策略

第五节 汽车电子市场发展存在的问题

一、市场面临挑战

二、产业制约因素

三、创新能力不足

第六节 中国汽车电子市场发展策略及建议

一、产业链构建策略

二、产业发展壮大对策

三、产业专项规划构思

四、网络营销策略分析

第七章 国外汽车芯片重点企业运营分析

第一节 高通

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、汽车芯片市场布局

四、恩智浦收购

五、市场发展规划

第二节 英特尔

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、新品研发进展

四、未来发展前景

第三节 英飞凌

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、汽车芯片业务

四、未来发展前景

第四节 意法半导体

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、产品研发进展

四、汽车半导体业务

五、未来发展前景

第五节 瑞萨科技

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、企业并购动态

四、企业合作动态

五、未来发展前景

第六节 博世

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、重点布局领域

四、未来发展前景

第七节 德州仪器

- 一、企业发展概况
- 二、经营效益分析
- 三、产品研发动态
- 四、助力互联网汽车
- 五、企业合作动态

第八节 索尼

- 一、企业发展概况
- 二、经营效益分析
- 三、销售市场形势
- 四、车用芯片业务
- 五、企业并购动态

第八章 中国汽车芯片重点企业运营分析

第一节 比亚迪股份有限公司

- 一、企业发展概况
- 二、经营效益分析
- 三、力推芯片国产化
- 四、未来发展前景

第二节 中芯国际集成电路制造有限公司

- 一、企业发展概况
- 二、经营效益分析
- 三、车用晶片业务
- 四、未来发展策略

第三节 大唐电信科技股份有限公司

- 一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、业务经营分析

四、汽车芯片业务

五、财务状况分析

六、未来前景展望

第四节 上海先进半导体制造股份有限公司

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、业务经营分析

四、企业合作动态

五、未来前景展望

第五节 珠海全志科技股份有限公司

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、业务经营分析

四、汽车芯片业务

五、财务状况分析

六、未来前景展望

第九章 中国汽车芯片行业投资机遇分析

第一节 投资机遇分析

一、产业爆发增长

二、巨头加速布局

三、智能汽车发展加速

第二节 产业并购动态

一、高通

二、三星

三、瑞萨电子

第三节 并购加速动因

一、汽车数字化推进

二、半导体行业助力

三、汽车数字商机爆发

四、车用晶圆技术发展

第四节 投资风险分析

一、宏观经济风险

二、环保相关风险

三、产业结构性风险

第五节 融资策略分析

一、项目包装融资

二、高新技术融资

三、bot项目融资

四、ifc国际融资

五、专项资金融资

第十章 中国汽车芯片产业未来发展前景展望

第一节 中国汽车电子市场前景展望

一、全球市场机遇

二、市场需求分析

三、十四五发展趋势

四、产品发展方向

第二节 中国汽车芯片产业未来前景预测

一、未来发展规模

二、市场规模预测

三、芯片需求市场

图表目录

图表：汽车芯片行业细分项目性能要求分析情况

图表：全球主要国家智能制造相关政策

图表：我国智能制造相关产业政策

图表：《国家集成电路产业发展推进纲要》对芯片产业的规划

图表：国家政策全力支持半导体领域发展

图表：工业互联网相关产业政策

图表：“互联网+医疗”相关政策

图表：2019-2023年前3季度gdp初步核算数据

图表：2019-2023年前三季度gdp同比增长速度

图表：2019-2023年前三季度gdp环比增长速度

图表：2011-2022年全球智能手机出货量和出货金额占比情况

图表：全球主要品牌厂商按交付量统计的市场占有率情况

图表：中国品牌汽车平均芯片数量(颗)

图表：国内部分汽车芯片技术研发进展

图表：igbt发展趋势

图表：算法新芯片发展路径

图表：汽车ecu

图表：汽车ecu架构

图表：汽车ecu与dcu架构

图表：cpu与gpu

图表：半导体材料价值占比

图表：半导体设备行业领先者和国内追赶者

图表：半导体材料在半导体行业所处的位置

图表：中国大陆半导体材料市场增速 vs.全球

图表：2019-2023年我国半导体材料市场规模(亿美元)

图表：国内半导体材料主要经营情况

图表：2011-2022年我国芯片设计企业销售额

图表：2011-2022年我国芯片设计企业数量

图表：国内芯片设计行业竞争格局

图表：国内模拟芯片主要产商发展情况

图表：2011-2022年集成电路设计布图专利申请情况

图表：国内半导体上市公司的海外发明授权量top

图表：中国芯片设计成长率(单位：十亿美元)

图表：晶圆技术节点及应用场景

图表：中芯国际与主流晶圆代工企业技术节点差距

图表：全球晶圆代工格局

图表：中国晶圆代工格局

图表：晶圆加工技术竞争格局

图表：封测技术在半导体产业链所处位置

图表：集成电路封装测试包括封装和测试两个环节

图表：我国封测业龙头拥有先进的封装技术

图表：中国在全球封测市场中占有率较高

图表：封装技术应用领域及代表性封装型式

图表：国内车载导航市场竞争格局

图表：2024-2029年中国自动驾驶汽车数量走势预测

图表：国内空调系统市场空间(单位：亿元)

图表：国内冷凝器市场空间(单位：亿元)

图表：2021 年全球汽车空调系统竞争格局

图表：国内空调市场汽车格局

图表：装有abs的主要车型

图表：汽车产品分类

图表：全球汽车电子系统市场规模

图表：2011-2022年我国汽车电子细分市场规模

图表：中国汽车电子市场规模情况

图表：我国汽车电子进出口情况(亿美元)

图表：2019与2022年汽车电子结构比较

图表：我国汽车电子竞争格局

图表：全志科技历史业绩情况

图表：我国车规级芯片竞争格局

图表：半导体硅片分类情况(毫米、微米、平方厘米、克、英寸)

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

本文地址 : <https://www.51baogao.cn/baogao/20220317/252300.shtml>

在线订购 : [点击这里](#)